



平成23年7月7日

各位

上場会社名 日置電機株式会社
 代表者 代表取締役社長 吉池 達悦
 (コード番号 6866)
 問合せ先責任者 取締役執行役員総務部長 巢山 芳計
 (TEL 0268-28-0555)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成23年1月25日に公表した平成23年12月期第2四半期累計期間の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成23年12月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成23年1月1日～平成23年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	8,700	1,400	1,400	840	61.64
今回修正予想(B)	8,300	1,070	1,050	780	57.23
増減額(B-A)	△400	△330	△350	△60	
増減率(%)	△4.6	△23.6	△25.0	△7.1	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成22年12月期第2四半期)	7,828	1,122	1,143	647	47.55

平成23年12月期第2四半期(累計)個別業績予想数値の修正(平成23年1月1日～平成23年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	8,100	1,200	1,400	850	62.37
今回修正予想(B)	7,550	830	1,030	770	56.50
増減額(B-A)	△550	△370	△370	△80	
増減率(%)	△6.8	△30.8	△26.4	△9.4	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成22年12月期第2四半期)	7,209	909	1,149	706	51.82

修正の理由

中国をはじめとする新興国の経済成長にも支えられ、当社グループを取り巻く環境は回復傾向にあります。特に半導体業界の設備投資が活発化し、前期において当社自動試験装置の売上高が大きく伸長しました。しかし、今期に入り同業界からの設備需要が当初予想に対して遅れているため、当第2四半期累計期間における売上高、利益が予想数値を下回ることになりました。

ただし、通期の業績予想については、当第2四半期累計期間における受注高が予想数値どおりであること、また今後自動車をはじめ東日本大震災の影響を受け落ち込んでいた製造業の生産回復が見込まれることから、据え置くことといたします。

(注)本資料に記載した業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以上